

性能特点

- 具有良好的导热性
- 单组分加热固化，便于操作
- 固化过程无副产物释放
- 优越的耐高低温、耐气候及介电性能
- 固化前有良好的触变性和粘性，接触热阻低，不任意流动，固化后柔软且应力小，无渗出物
- 器件使用后可重工

产品描述

PAKCOOL® TC-9165-T 是可重工单组份加成型加热固化液态膏状导热填缝剂。固化前为液态膏状，可通过自动化点胶、丝网印刷等多种操作方式施工于发热面和散热面之间，与界面有非常好的接触性，经过高温固化形成柔软的凝胶状产品，不仅应力小，而且具有更加优异的使用稳定性。本产品既克服了湿气固化产品的固化时间长的缺点，同时又兼具了硅脂或导热泥非固化型产品的低应力和可重工性，便于后期的维护和修复；亦可称为可自动点胶的导热垫片，比导热垫片操作方便、接触热阻低，相同导热系数可以使器件温度更低，同时能够填充缝隙大且极不平整的界面。

本产品还具有导热性能高、绝缘性能好以及填充间隙大等优点，可广泛用于各种领域有导热需求的电子器件。

典型应用

- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 控制器
- 通讯设备
- 计算机及其附件

注意事项

- 如客户需要更详细的说明，请与我公司市场销售部联系。他们会随时为您解答和服务。

技术参数

特性	TC-9165-T	测试方法
外观	白色	Visual
粘度 (cP)	85 万	ASTM D2196-20
导热系数 (W/m·K)	6.5	ASTM D5470
密度 (g/cm³)	3.40±0.30	ASTM D792
固化时间 (min)	10 (@150°C) 120 (@100°C)	--
硬度 (Shore OO)	40±30	ASTM D2240
介电强度 (kV/mm)	≥5	ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	≥1.0×10 ¹²	ASTM D257
储藏时间 (@10~25°C)	40 天	--
储藏时间 (@-25~-10°C)	4 个月	--
连续使用温度(°C)	-50~+150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 涂胶前，元器件表面应保持清洁。
- 使用时带防护眼镜和防护手套，使用环境需通风。
- 产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砜、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等。

包装储运

- 本产品可提供 30mL、55mL 点胶针筒，330mL 胶瓶，或根据客户要求定制包装。
- 本产品为无毒、不易燃材料，可作为普通化学品运输，运输时间不超过 7 天，收到货后立即低温存储。存储时应平放，在 10~25°C 环境下保存不超过 40 天，在 -25~-10°C 环境下保存不超过 4 个月；使用前须在 25°C 下回温至少 4 小时，使胶料温度与使用环境温度一致后再使用。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。